

**6406 シリーズ 取扱い説明書**  
**INSTRUCTION MANUAL**

**SERIES 6406**  
**0.6 mm PITCH 200 PIN**  
**DDR CONNECTOR**

O	EDN-362	5/27 '08			
No.	EDN/DCN	DATE	PREPARED	CHECK	APPROVED

## 1. 概要 SCOPE

本製品 6406 シリーズコネクタに於いて、嵌合・離脱時の注意点について掲載します。

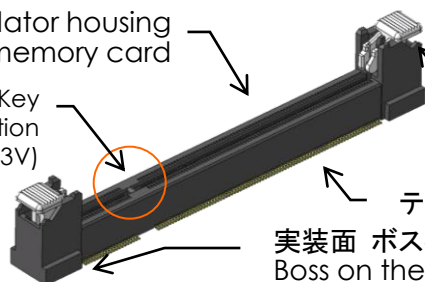
This manual contains cautions in handling Series 6406 DDR Connector when a memory card is inserted and/or removed.

## 2. 各部の名称 Part names

6406 シリーズ DDR コネクタ      Series 6406 DDR Connector  
200PIN ST SMT                      200 pins, ST, SMT

INS ハウジング Insulator housing  
嵌合スロット Slot for memory card

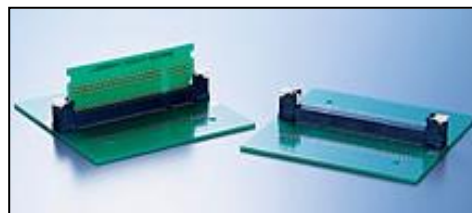
Key  
(Different position  
for 1.8V and 3.3V)



排出レバー Ejection lever

テール Tails

実装面 ボス有（手載せ対応用）  
Boss on the mounting face (for manual  
placing)

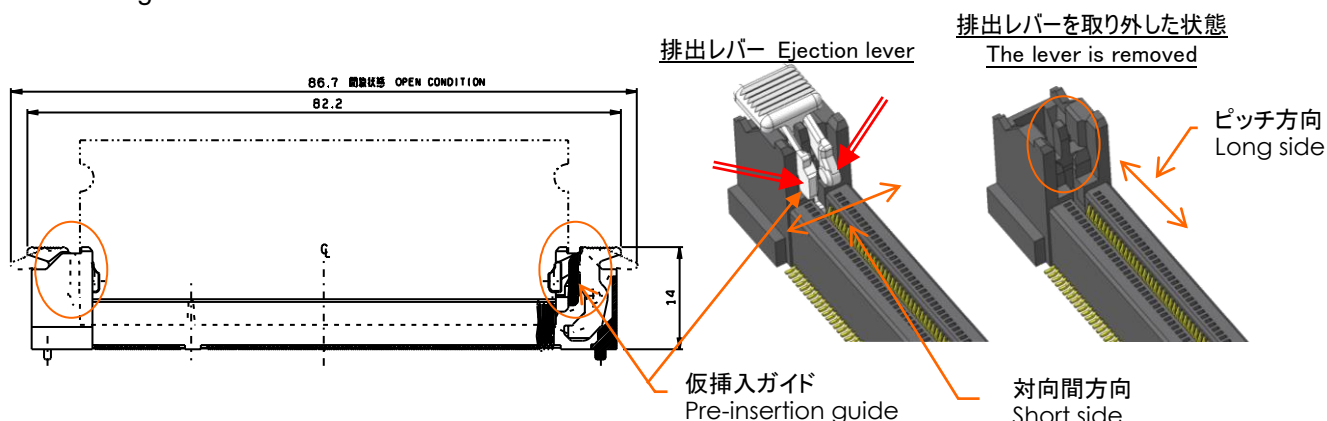


## 3. 嵌合離脱について Inserting and/or removing a card

### 3-1. ①カード基板の仮嵌合 Pre-insertion of a memory card

カード基板は INS ガイドと排出レバーにより位置決めされ、仮挿し位置まで挿入します。  
このとき、レバーは対向間方向、INS ガイドはピッチ方向へのガイドの役目を果たします。

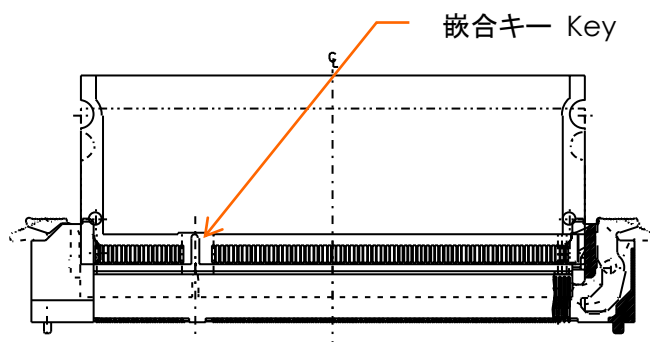
The position of the card is fixed by the insulator guide and the ejection lever. So the card is inserted up to the pre-insertion position while the lever is for positioning of short side and the guide for long side.



### 3-2. ②嵌合キー位置の確認 Key for inserting a memory card

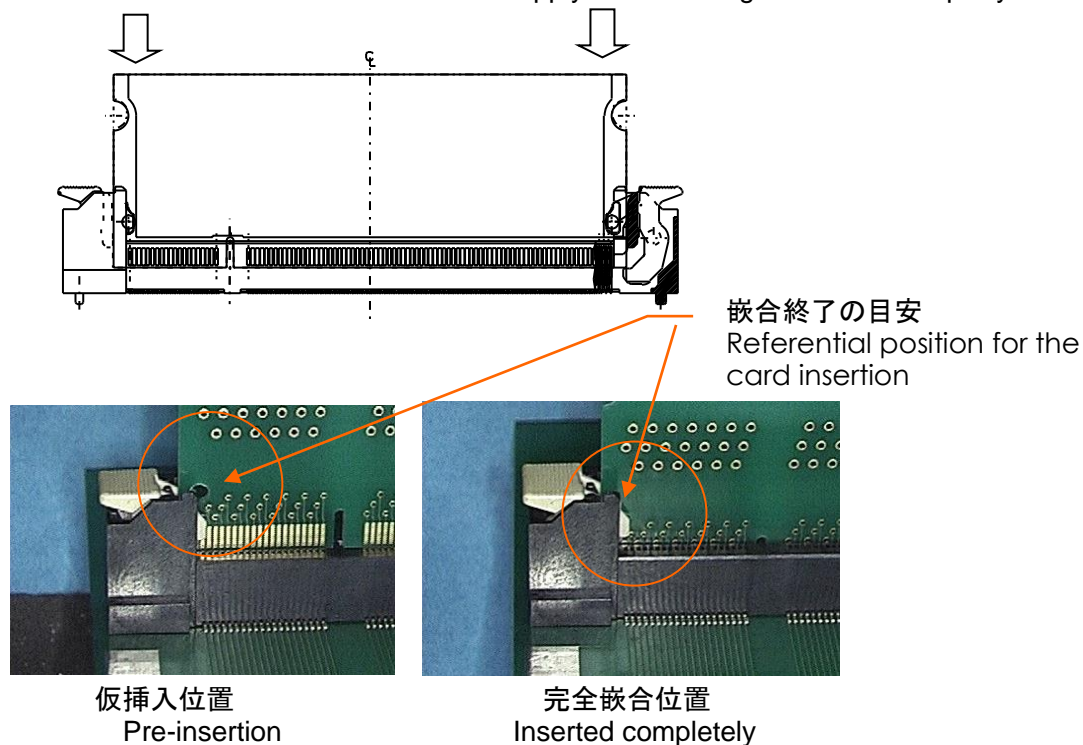
嵌合キー位置がカード基板とコネクタで合致していることを確認ください。  
規格上 1.8V と 3.3V ではキー位置が異なり、誤嵌合防止となっています。

Make sure that the keys on the memory card and in the connector are matched. The key positions for 1.8V and 3.3V cards are different to prevent the wrong insertion.



## 3.3 ③ 嵌合押し込み Depressing the card

真っ直ぐ均等に荷重を掛けてください。Apply a force straight downward equally on both sides.



## 3.4 カード排出 Ejecting a card

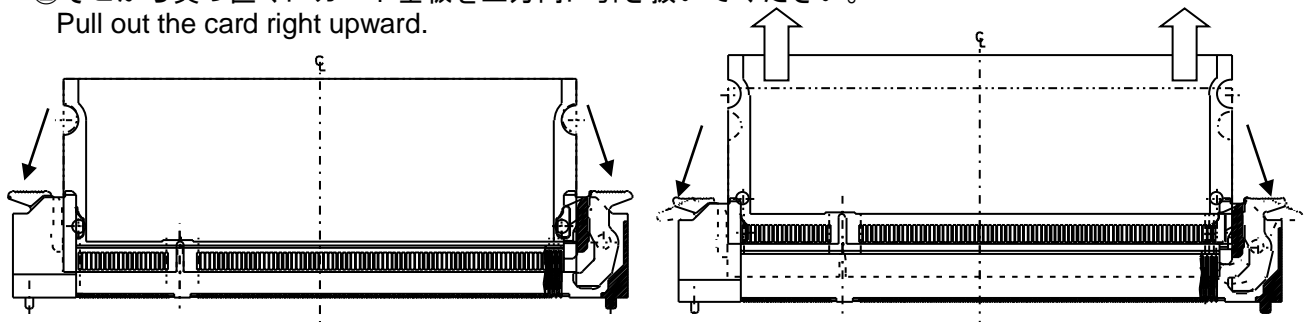
① 左右の排出レバーを下げてください。

このときカードは飛び出し落下防止からコネクタに保持されたままになります。

Depress the ejection levers on both sides. The card retains in the connector due to the structure to prevent it from popping out.

② そこから真っ直ぐにカード基板を上方向に引き抜いてください。

Pull out the card right upward.



ご注意)

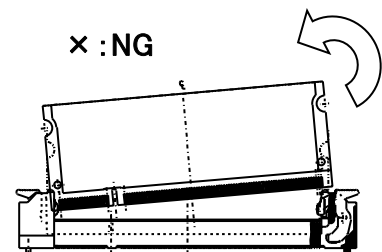
- ・ レバー操作せずに基板を引き抜かないで下さい。
- ・ 斜めに引き抜かないで下さい。
- \* 排出レバーの操作を行った後に多少斜めでも INS ハウジングが破損することはありません。
- 必ず排出レバーの操作を行ってください。

Notes)

-Make sure to depress the ejection levers before pulling out the card.

-Do not pull up both sides unequally as shown on the right.

\*Even when the card is pulled up slightly aslant, the insulator housing will not be broken only when the ejection levers are surely depressed before the card is pulled up.



## 3-5. 取り扱いの注意 Cautions in handling

嵌合離脱の操作では上記の手順を守ってください。Be sure to follow the procedures below.

## 『嵌合の際』 When inserting the card

①仮嵌合 Pre-insertion⇒②嵌合キーの位置確認 Checking the key position⇒③押し込み Depressing  
嵌合キーが確認できない状態から一気に押し込まないで下さい。

Make sure to confirm that the key positions of the card and the connector are matched before depressing.

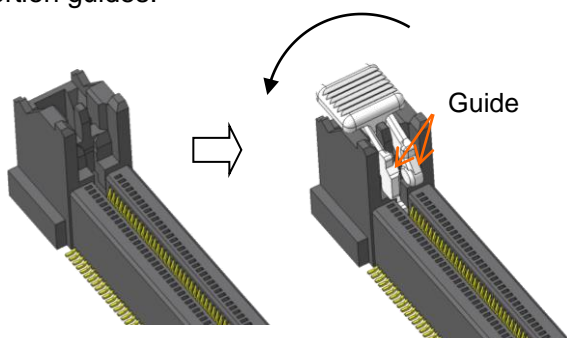
## 『離脱』 When removing the card

①レバーを下げて排出 Depress the levers⇒②仮保持状態からの引き抜き Pull out the card from the retained position.

(補足：排出レバーの外れ) When the ejection lever is come off

通常の操作で外れることはありませんが、万が一排出レバーが外れた場合は嵌合ガイドを破損させないように注意しながら、レバーを置き下向きに押し込んでください。

When the lever comes off though it does not come off under the normal usage conditions, place back the lever at the proper position and push downward while paying attention not to break the insertion guides.



→の向きに回転させるように軽く置き、ぱちんと感覚があるまで最後に押し込んでください。

\* ガイドを破損させないこと

Put the lever lightly by turning the lever in the direction shown by the arrow, and depress the lever until it snaps.

\*Do not break the guides.

\* 排出レバーは故意に取り外さないで下さい。

Do not remove the ejection lever on purpose.

## 3-6. カード基板の取り扱いについて Notes on memory card boards

カード基板パッド（接触部）は JEDEC に定める、Au0.76 $\mu$ mまたは処理剤（ルブリカントオイル）を用いた、Au0.76 $\mu$ m同等の Au めっきの品質を確保ください。カード基板は Au 接点パッドが露出しています。素手でパッド部に触れないで下さい。油分や汗により Au めっきの劣化、処理剤の剥がれが無いようにご注意ください。カード基板のリフロー実装後に、Au パッド部の処理剤などによる清掃を推奨します。

Please make sure that the pads (contacting parts) on memory cards shall be Au 0.76 $\mu$ m specified by JEDEC or plated with Au equivalent of Au0.76 $\mu$ m with lubricant oil.

Since Au pads are exposed on cards, do not touch pads with bare hands, or Au plating would deteriorate and/of the lubricant oil would be removed by oil or sweat.

It is recommended to clean Au pads on cards after the cards are reflow-mounted.